

<<电子组装技术与材料>>

图书基本信息

书名：<<电子组装技术与材料>>

13位ISBN编号：9787030314857

10位ISBN编号：7030314859

出版时间：2011-8

出版时间：科学出版社

作者：郭福 编译

页数：362

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子组装技术与材料>>

内容概要

郭福等编译的《电子组装技术与材料》选取了国外知名原版教材中与电子封装及组装技术和材料相关的英文章节，并配以中文译文编写而成。

主要内容包括：电子产品制造简介，硅晶片的制造，集成电路组装技术，芯片制造，表面组装技术，电子封装用金属材料、高分子材料、陶瓷材料，印制电路板，材料性能表征与测试，焊膏印刷及元器件贴装，钎焊原理与工艺，检验与返修，电子封装的可制造性设计，可靠性设计与分析。

《电子组装技术与材料》可作为学生双语教学的教材，特别是阅读材料，使教学既有重点内容的体现，又有深度、广度的扩展。

同时，也可作为电子组装工程领域专业技术人员的参考资料。

<<电子组装技术与材料>>

书籍目录

前言

第一篇 入门篇——电子产品制造技术简介

第1章 电子产品制造简介

第2章 硅晶片的制造

第3章 集成电路组装技术

第4章 芯片制造

第5章 表面组装技术

第二篇 材料篇——电子组装用材料

第6章 电子封装用金属材料

第7章 电子封装用高分子材料

第8章 电子封装陶瓷材料

第9章 印制电路板

第10章 材料性能表征与测试

第三篇 工艺篇——主要电子组装工艺技术

第11章 焊膏印刷以及元器件贴装

第12章 钎焊原理与工艺

第四篇 可靠性篇——电子组装结构的设计可靠性

第13章 检验与返修

第14章 电子封装结构的可制造性设计

第15章 可靠性设计与分析

<<电子组装技术与材料>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>